# 精智达 20260906

## 存储测试设备领军者：18G 超高速机获首单，2027 年业绩预增翻倍

## 摘要


- 订单爆发式增长：2026 年新签订单已超 35 亿目标，正冲刺 40-50 亿+；预计 2027 年订单与收入将实现翻倍增长。
- 18G 超高速测试机突破：获首批 5 台订单（单价数千万），占总订单近 30%；系国内首家且唯一获此订单厂商，技术指标对标并部分超越国际竞品。
- HBM 与存储测试增量：HBM 测试时长为普通 DRAM 的 20-30 倍，单万片产能对应设备价值量呈数倍增长；预计 FT 设备年市场需求接近 100 亿元。
- 探针卡业务国产替代：3DMEMS 探针卡已实现批量高毛利出货，单张价值数百万；公司系国内首家量产厂商，受益于 DRAM 及 HBM 扩产需求。
- 算力芯片测试布局：计划 2026Q4 推出 1.6G 高阶 SoC 测试机，对标国际 993KXR 标准；已对接 5 家头部客户，预计 2028 年成为新增长点。
- 盈利能力持续上行：综合毛利率从 2024 年 33%升至 2026H1 的 44%，中期目标 50%-60%；净利润率目标设定在 20%-30%区间。
- 交付与供应链保障：18G 设备 2026 年 10 月起交付；通过提前备货自研 ASIC 芯片及锁定核心产能，应对供应链交期拉长风险。


## Q&A

### 公司近期新签订单的总体情况如何，特别是最新公布的近 16 亿元订单的具体构成和交付计划是怎样的？

公司近期新签订单已超年初预期，在手订单充足。除了年初的 13 亿元订单和此次近 16 亿元的订单外，半年内还陆续获得了多笔较为零散的订单，涵盖测试机、探针卡以及 AI 和显示业务。 最新公布的近 16 亿元订单中，包含了市场关注度高的 18G 高速测试机，这也是国内首批此类超高速测试机的订单。具体而言，该订单中有 5 台 18G 高速测试机，首批设备计划于下个月（2026 年 10 月）交付，剩余部分将在 2027 年上半年陆续交付完成。

## 公司在高速测试机领域的研发进展和市场策略是怎样的，特别是 18G 高速测试机的技术优势和研发背景是什么？

公司在高速测试机领域采取了前瞻性的布局。18G 高速测试机的研发项目于 2024 年下半年就已立项，旨在满足未来 2-3 年客户对更高速度存储芯片的测试需求。随着存储芯片速率从 9.6G、10.8G 向 14.4G 甚至更高频率发展，18G 测试机将成为市场的必然选择。 该产品的研发基于 9G 测试机的技术积累。公司在过去一年中，通过对 9G 设备在客户端的持续验证、迭代和完善，为 18G 的开发奠定了坚实基础。18G 测试机是在 9G 设备的硬件和软件架构上进行升级而来。其核心部件 18G ASI 芯片在两年前就已启动研发，并于 2025 年成功回片，是国内首个 18G ASI 芯片。2026 年以来，公司持续对该芯片及工程样机进行校正、验证与调试，目前进展顺利。此次获得 18G 测试机的批量订单，标志着客户对公司研发成果及未来交付能力的认可。

## 公司探针卡业务在 2026 年的发展亮点、技术突破以及市场前景如何？

探针卡业务是公司 2026 年的一个主要亮点，订单情况良好。在后段 CP 测试中，探针卡是关键战略物资，尤其 DRAM 探针卡市场长期被国外供应商垄断，且面临地缘政治和供应周期长的风险，因此客户对国内供应链的需求非常迫切。 公司在探针卡领域布局已久，致力于核心技术研发和关键零部件的本地化。2026 年取得了重大技术突破，采用与美国同行相同技术路线的 3D MEMS 探针卡已成功交付多张，并通过了客户端针对 DRAM 在 125 度高温 burn-in 环境下的量产验证，测试了数千片晶圆，在良率和正常运行时间（up time）方面表现理想，获得了客户的高度认可。随着客户产能提升、新产品推出以及对更高速度晶圆的测试需求增加，探针卡的需求将快速增长，公司有望成为核心客户的主力供应商，市场份额和产品毛利率预计将随自研的 3D MEMS PIN 技术和工艺的成熟而显著提升。

## 公司在 KGS（Known Good Stack）测试领域的业务布局和进展情况如何？

针对 KGS 晶圆段测试这一全新的需求，公司已全面推出覆盖各环节的测试设备。产品线包括晶圆级老化（Wafer Level Burn-in）设备、阵列测试的 CP 测试机以及高速测试机。目前，这些设备正在客户端加紧进行验证，进展顺利。期望随着客户相关产品在 2027 年进入上量阶段，公司的设备验证进度能与之匹配，从而获取更多订单。

## 公司对 2027 年的订单、收入及盈利能力的展望是怎样的？

基于 2026 年打下的良好基础，公司对 2027 年的业绩增长非常乐观，预计订单和收入有望实现三位数的增长，即翻倍增长。增长的驱动力主要来自几个方面：首先，多条产品线研发验证进展顺利，预计到 2027 年将有更多产品进入客户的采购清单。其次，存储芯片向更高速度、更大容量发展，导致测试环节的价值量显著提升，测试站点和测试时间的增加将创造更多设备需求。再次，客户的扩产速

度超出预期，且由于设备交付周期较长，客户倾向于提前下单，这将带来更多采购需求。综合来看，预计 2027 年公司的订单、业绩、毛利率及净利润水平均将有显著提升。

**除了存储芯片测试业务，公司在算力芯片测试领域有何布局和规划，预计何时能成为新的业务增长点？**

公司在算力芯片测试领域的研发进展顺利，计划在 2026 年第四季度推出对标国际同行 993K XR 最高端标准的 SoC 高阶数字测试机。该测试机规格较高，测试频率可达 1.6G，主要面向算力芯片测试和高端消费类芯片测试两大市场。目前，公司已与这两个领域的关键客户进行了长时间的技术对接和前期验证工作。下一步将继续推进项目验证，预计在 2027 年取得一些突破，并有望在 2028 年成为公司一个新的业务增长点。

**公司在客户拓展方面有何新计划？**

在现有核心客户业务稳固增长的同时，公司计划在 2027 年拓展新客户。目前正在与位于武汉和福建的新客户进行密切对接。

**公司近期新签订单的具体情况如何，尤其是其中高速测试机的占比和交付计划是怎样的？同时，基于当前时点，公司对 2026 年全年的订单目标以及 2027 年的增长预期有何展望？**

公司近期公告了近 16 亿元人民币的订单，进一步巩固了在存储测试设备领域的技术与业务优势。此订单的一大亮点是包含了 5 台 18G 超高速 FT 测试机，单台设备金额达数千万元人民币，这部分价值量占整个订单总额接近 30%。这是继国际厂商之后，公司成为第一家也是目前唯一一家获得 18G 超高速 FT 测试机采购订单的厂商，该设备为国内市场的第二台。根据过往订单经验，预计超高速测试机将从 2026 年 10 月开始陆续交付，并在 2027 年上半年内全部交付完毕，整个订单力争在一年内完成完整交付。 基于下游市场的高景气度，公司年初设定的 35 亿元全年订单预期已经提前完成。目前，公司正努力向全年新签订单四五十亿元甚至更高的目标迈进，具体数额将取决于下游客户的整体扩产节奏。展望 2027 年，全年预期非常乐观，订单能见度正逐步清晰，预计将较 2026 年实现翻倍增长。在 2027 年的订单结构中，包括 FT 测试机和用于 HBM 的 CP 测试机在内的高速测试产品，其占比有望超过 30%。

**关于此次订单中备受关注的 18G 超高速 FT 测试机，其技术规格、核心竞争优势以及在产品线中的战略定位是怎样的？**

18G 超高速 FT 测试机是公司乃至整个行业内最新可交付的最高级别存储测试产品。该产品早在两年前便已立项研发，基于公司自研的 ASIC 芯片打造，其技术规格已达到国际水平，部分指标甚至实现了超越。具体而言，该测试机能够匹配

从 DDR5X 到 DDR6 以及 LPDDR6 等更高世代的 DRAM 芯片测试需求，是国内首款完成工程验证并即将进入量产的同规格测试设备。相较于国际竞品，其核心优势体现在：通道数量是国际竞品的 1.5 倍，能有效降低客户的测试成本；在通道密度和测试效率方面也实现了超越。 该产品继承了公司成熟的 9G 高速测试机平台架构，大幅缩短了验证周期。它能够向下兼容 9.6G、10.8G、12.8G、14G 等多个速率档位，实现对全系列高速 DRAM 测试需求的覆盖，支持客户未来的持续扩产计划。除了产品性能，公司在价格、交付周期和现场响应速度方面也具备显著的本土优势，综合来看能够提升客户的测试效率并降低其成本。 在产品线战略上，18G 超高速产品的成功交付，不仅巩固了公司在 9G 高速测试机市场的先发优势，更奠定了公司在该领域至少两年以上的量产验证经验优势，有望成为后续设备的基线版本。这些从中低速、9G 到 18G 积累的经验，将反馈至后续 22G、36G 及更高速率产品的研发中，进一步巩固公司的技术护城河。

**除了测试机业务，公司在探针卡业务方面的进展如何？在 DRAM 和面板测试领域，公司具备哪些独特的综合竞争优势？**

在探针卡业务方面，公司已经实现了全流程的自研量产，是国内首家能够量产 3D MEMS 探针卡的厂商。2026 年以来，该产品已实现批量、高毛利率的出货，单张价值量达到数百万元级别，并且在核心客户的复杂测试中获得了高度满意。随着 HBM 扩产和 CP 测试需求的提升，探针卡市场规模预计将在现有十几亿元的基础上实现成倍数级的增长。公司的目标是在已成为核心客户最主要供应商的基础上，进一步提升市场份额。 公司的综合竞争优势体现在多个维度：首先，是唯一能够提供全品类、系统化解决方案的测试设备厂商；其次，是目前唯一拥有 DRAM 长期量产经验的厂商，在高速测试和老化测试等领域能满足客户旺盛的扩产需求；再次，是唯一拥有自研 ASIC 能力并在高速及超高速测试领域取得突破的厂商。在面板领域，虽然测试方式与 DRAM 有所差异，但主要测试站点和核心技术具有很强的共通性，公司在满足现有客户需求的基础上，也将提供 9G 以上版本以支持产业升级。这些独特的优势使公司对在存储领域的业务拓展充满信心。

**面对 2026 年和 2027 年订单的数倍增长，公司在产能和供应链方面做了哪些准备？当前面临的主要挑战是什么，以及应对策略为何？**

为应对订单的快速增长，公司自 2025 年起已开始大规模扩充产能，并在 2026 年显著提升了人员规模和生产场地。关键在于供应链方面，公司已对关键元器件实现提前备货，并为自研的 ASIC 核心芯片做了充足准备，这使得准备工作更为充分。2027 年，公司将继续扩产，以支撑订单逐年翻倍的交付需求。 当前面临的最大压力和挑战来自供应链，核心部件的交期正在变长，不确定性增高，部分物料还可能面临涨价风险。为应对这些风险，公司的主要策略是提前布局和备货。目前，核心产能已提前锁定，并根据客户的节奏分季度下达订单，确保未来一段时间的订单预期得以满足。因此，对于大规模订单的交付，整体风险是可控的。公司会设定交付优先级，优先保障战略客户的交付需求。

人在草木间

公司在 NAND 和 SoC 测试产品线的最新进展如何，特别是在技术布局、客户验证以及市场策略方面有哪些具体规划？

在 NAND 业务方面，该产品属于存储测试的大类，与 DRAM 测试在技术上有共通之处。公司在高速测试和老化测试领域具备显著优势，能够解决客户在产能扩张中遇到的痛点。公司推出的 9 级以上版本的新产品，能够很好地契合国内领先 NAND 客户未来的生产需求，相关产品预计将在近期交付，并体现在订单中。公司对在存储领域已有的量产经验和技术优势充满信心，这是与不同客户展开合作的基础。在 SoC 或算力芯片测试机方面，公司早在六年前便已开始布局，采取了在子公司和上市公司层面同步投入的策略。在发展存储测试机的基础上，公司打造了包括底层高速信号、向量生成、电源等在内的共用技术平台。尽管 SoC 芯片测试机的架构和软件生态与存储测试机存在差异，但两条路线均取得了重大进展。在上市公司层面，工程机等相关产品在客户端已取得可观进展，测试速率达到 1.6Gbps，对标国际最领先产品，并已开始在公开场合推广。目标客户主要分为两类：一类是 GPU 或 AI 商用芯片厂商，另一类是消费类大芯片厂商。目前已与至少 5 家国内头部客户进行对接验证，其中 2 到 3 家进展较快，期望在 2026 至 2027 年完成验证和批量订单工作。 此外，公司观察到 AI 与 HBM 异构集成时代带来的一体化成套测试解决方案的新趋势，这构成了公司独特的优势。大量的跨芯片复合测试需求，对 ATE 设备在硬件和软件上都提出了更高要求，需要同时具备高精度电源、高速测试能力、多站点并行以及与探针台等配套的系统化解决方案。依托在存储及 HBM 测试方面的能力，结合在 AI 领域的储备，公司能够提供存储加算力芯片一体化的复杂测试机型方案，为有更复杂测试需求的国内客户提供更具针对性的解决方案，这被视为公司在该领域符合未来市场发展的最大优势。

考虑到 AI 芯片和 HBM 带来的测试时长增加，国内头部 DRAM 客户的产线及其 HBM 扩产，预计将为每万片晶圆带来多大的测试机价值量增量？

无法针对具体客户进行回复。但从整体测试需求来看，仅 ATE 的 FT（Final Test）设备，未来每年的市场需求预计接近 100 亿元。在此前 DDR4 时代，每 10 万片产能约对应六七十亿元测试设备需求的基础上，预计未来整体扩产带来的需求至少有 2 到 3 倍的增长，具体增长幅度取决于技术演进情况。HBM 测试将是未来采购的核心增量，其测试环节多，测试时长可能是普通 DRAM 的 20 至 30 倍。因此，保守估计，单万片 HBM 产能对应的测试设备价值量将是普通 DRAM 的数倍以上。公司目前在 CP（Chip Probing）和 FT（Final Test）产品上均采用了高速测试方案，对于未来市场需求实现数倍甚至在特定时期内达到 10 倍级别的增长，抱有非常乐观的期待。

鉴于公司 2026 年订单已超预期，当前对 2026 年的收入目标是否有超预期的可能？对 2027 年的展望以及公司未来的毛利率和净利润率趋势有何指引？

公司的订单数量已超过年初预期，将尽全力推动收入确认，交付节奏很快，因此对收入表现持乐观态度。 在盈利能力方面，具体分析如下： 首先，关于毛利率，

公司综合毛利率呈现持续提升的趋势，从 2024 年的 33%，到 2025 年的 37%，再到 2026 年上半年的接近 44%。这一增长是在原材料成本攀升、快速扩产导致生产成本增加，以及前期导入前沿产品导致产品结构成本偏高的不利情况下实现的。随着 2026 年及 2027 年主力产品进入量产交付阶段，毛利率有望进一步上升。短期的毛利率目标区间为 45%至 50%，中期目标为 50%至 60%，力求向国际同行看齐。在特定的先进产品上，毛利率水平预计会更高，可达到 60%至 70%；而在量产经验较丰富的产品（如老化测试机）上，毛利率可能落在 45%至 50%的区间。 其次，关于净利润率，目前公司为保障客户在扩产过程中能使用最前沿技术、提升行业良率，仍在进行大力度的研发投入。2026 年上半年研发投入比例接近 20%，预计未来一段时间内仍将保持较高强度，这是保障核心竞争力的长期必要投资。尽管如此，公司未来的净利润率目标设定在 20%至 30%之间。该指标可能会受到研发团队投入、股份支付成本等因素的阶段性波动影响，但公司始终会将保持产品竞争力和未来盈利能力作为产品推广与技术投入的重要标准。